

SEMI G72.1-0997

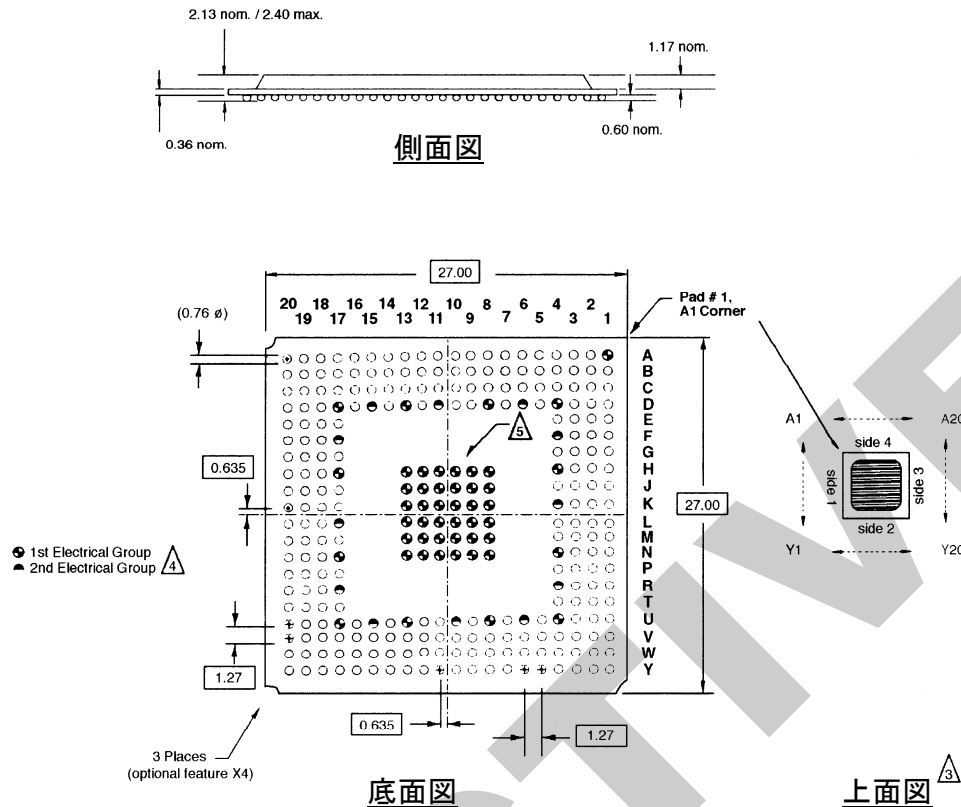
ボールグリッドアレイ設計ライブラリのための設計提案: 292 ピンプラスチックボールグリッドアレイ

免責事項:この SEMI スタンドアードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

表 1 プラスチックボールグリッドアレイ (PBGA) 一般設計特性

ボール 計数	信号 I/O	本体寸法	ピッチ	マトリックス	アレイ	熱強調	プロファイル 高さ	キャビティ 方向	ワイヤボン ド リング
292	231	27×27	1.27	20×20	まばら	6×6	2.13	上	2

基板材料	金属層	ダイ相互 接続	パッケージング 設計/材料		ボール 組成	JEDEC 分類記号	予調整 レベル	設計番号	SEMI 分類記号 番号
BT 積層	2(2S0P0G)	ワイヤ ボン ド	オーバー モールド	エポキシ	63/37 Sn/Pb	MO-151 BAL-2, B	レベル 3, 改訂 0	PBD0001	G72.1



注:

- 示されていない全ての寸法と許容誤差に関しては、JEDEC MO-151 事項 B 偏差 BAL-2 参照。この設計は、基準とされる JEDEC 外形図面と完全に適合していなければならない。
- 全ての寸法は、別に注釈がない限り、ミリメートルである。
- 上面図は、外部パッケージフィーチャ、内部ワイヤボンダッド番号 1、並びに内部ワイヤボンダッドの側面 1, 2, 3, 及び 4 との関係を図示している。特定の電気的接続及びより詳細な注釈に関しては、SEMI 規格 BGA 設計ネットリスト参照。
- この記号を持つハンダボールは、共通の電気的接続を持っており、またその他の内部パッケージフィーチャに接続されていてもよい。その他特定の電気的接続に関しては、SEMI スタンダード BGA 設計ネットリスト参照。
- 6×6 ハンダボールの熱強調が示されている。その他特定の電気的接続に関しては、SEMI スタンダード BGA 設計ネットリスト参照。

Ball Count	Signal I/O	Body Size	Pitch	Matrix	Array	Thermal Enhanc.	Profile Height	Cavity Orientation	Wirebond Rings	Substrate Materials	Metal Layers	Die Inter-Connect	Encap. Design	Encap. Material	Ball Comp.	JEDEC Design	Preconditioning	
292	231	27 x 27	1.27	20 x 20	depot.	6 x 6	2.13	up	2	BT	2 (250PFG)	wire bond	over mold	epoxy	63 / 37 Sn / Pb	MO-151 BAL-2, B	LEVEL 3, Rev. 0	
BGA DESIGN LIBRARY DRAWING TITLE						BGA DESIGN LIBRARY NO.				SEMI STANDARD BGA DESIGN LIBRARY General Specification						REV.	DATE	PAGE
292 PIN PLASTIC BALL GRID ARRAY 27 X 27mm BODY DESIGN						PBD0001										INITIAL	4/15/96	1 OF 8

図 1

292 ピンプラスチックボールグリッドアレイ 27×27 mm 本体設計

表 2 292 ピンプラスチックボールグリッドアレイ 27×27 mm 本体設計

Design No. PBD0001	SEMI Standard BGA Design Library		Revision Initial	Date 6/20/96	Page 2 of 8
PBGA Wire Bond Pad (*1)	Solder Ball Location	Die Wire Bond Pad	I/O Name (& Comments) (*4)	Pkg. Side (*1)	Notes
w/b ring 1	A1				3
230	A2			4	
225	A3			4	
222	A4			4	
218	A5			4	
215	A6			4	
213	A7			4	
210	A8			4	
206	A9			4	
202	A10			4	
201	A11			4	
198	A12			4	
194	A13			4	
191	A14			4	
188	A15			4	
184	A16			4	
181	A17			4	
180	A18			4	
175	A19			4	
174	A20			3	
1	B1			1	
229	B2			4	
228	B3			4	
224	B4			4	
221	B5			4	
217	B6			4	
214	B7			4	
211	B8			4	
207	B9			4	
203	B10			4	
199	B11			4	
197	B12			4	
193	B13			4	
190	B14			4	
187	B15			4	
183	B16			4	

Design No. PBD0001	SEMI Standard BGA Design Library			Revision Initial	Date 6/20/96	Page 2 of 8
PBGA Wire Bond Pad (*1)	Solder Ball Location	Die Wire Bond Pad	I/O Name (& Comments) (*4)		Pkg. Side (*1)	Notes
177	B17				4	
176	B18				4	
173	B19				3	
171	B20				3	
6	C1				1	
2	C2				1	
231	C3				4	
227	C4				4	
223	C5				4	
220	C6				4	
216	C7				4	
212	C8				4	
208	C9				4	
204	C10				4	
200	C11				4	
196	C12				4	
192	C13				4	
189	C14				4	
185	C15				4	
182	C16				4	
178	C17				4	
172	C18				3	
170	C19				3	
167	C20				3	
7	D1				1	
3	D2				1	
4	D3				1	
w/b ring 1	D4					3
226	D5				4	
w/b ring 2	D6					2
219	D7				4	
w/b ring 1	D8					3
209	D9				4	
205	D10				4	
w/b ring 2	D11					2
195	D12				4	
w/b ring 1	D13					3
186	D14				4	